



## 科研产出

- 论文 >
- 专利 >
- 专著 >

当前位置 > 首页 > 科研工作 > 科研产出 > 专利

专利名称:	一种低温晶圆键合方法
专利类别:	发明专利
申请号:	201210491190.2
申请日期:	2012-11-27
专利号:	201210491190.2
第一发明人:	刘洪刚;李运;王盛凯;张雄;郭浩;孙兵;常虎东;赵威
实施情况:	授权
专利证书号:	201210491190.2
其它备注:	高频高压中心

